

デジタルインフラ会合

2026年7月1日、チリの産官学関係者を招いたデジタルインフラに関する会合を開催しました。本会合には、ロミナ・ガリド通信次官をはじめ、この分野におけるチリの主要な代表者が参加しました。総務省から FOIP デジタル回廊構想に基づく国際連携の重要性について紹介するとともに、日本のデジタルインフラ技術を活用した日チリ間の協力の可能性について議論を深めました。

